证券代码：301348　　证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观 ☑其他（电话会议）
参与单位名称/人员姓名	易方达基金、银河证券、华泰证券、心远基金、睿和投资、沁闻投资
时间	2026年02月10日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书张国光、证券事务代表林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	**1、关于公司的主营业务与产品结构，细分品类、规格及应用场景** 回复：公司从事半导体封装测试业务，主要为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品，产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC、LED 驱动 IC 及霍尔器件等集成电路产品。 公司封装产品系列丰富，拥有 QFN、DFN/PDFN、SOT/TSOT、SOP/ESOP/HTSSOP、TO/TS 等系列多种型号的封装产品；产品结构多样，能够满足消费类电子、电源、电声、家用电器、汽车电子、网络通信、安防、便携电子设备、新能源等多个应用领域的需求。公司通过“自有品牌+封测服务”的业务模式，为客户提供一站式的半导体封测产品及服务。 **2、公司自有品牌和封测服务业务的情况** 回复：公司围绕半导体封装测试，主营业务稳步发展，整体实现营收规模平稳增长，业务结构持续优化；自有品牌业务聚焦半导体分立器件及相关集成电路领域；封测服务与自有品牌营收占比基本持平，形成深度协同，为自有品牌产品提供稳定的封装业务配套保障。 **3、公司上下游采购及销售情况，行业复苏节奏对公司订单的影响** 回复：关于上游核心原材料采购，公司核心原材料以金属原材料、塑封料等为主，采购渠道聚焦国内优质供应商并拓展多元渠道，供应商集中度低，无单一供应商依赖，可保障采购稳定与性价比；原材料采购价格受大宗商品、供需等因素影响有阶段性波动，其中金属原材料与金、铜、铝行情关联度高，公司通过签订长期合作协议、优化采购计划、推进国产化替代及材料替代应对价格波动，目前原材料供应充足，暂无短缺风险，当前原材料涨价存在有阶段性影响，但通过降本及产品结构优化，整体影响可控。 下游客户方面，公司客户覆盖消费电子、汽车电子、新能源、工业控制等领域，公司与核心客户保持长期稳定合作；下游客户对产品小型化、集成化等要求持续提升，与公司研发方向高度契合，公司已做好产能及技术储备，可及时响应客户需求、把握行业复苏机遇。 **4、公司 2025 年及未来年度的营收、利润目标，盈利改善的具体举措；公司后续融资需求、投资计划（如拟收购成都芯翼科技股权相关的资金安排），以及**

	资本运作计划（并购、股权投资等） 回复：公司将以实现营业收入稳步增长、经营利润持续改善为核心目标，通过优化产品结构、提升高附加值产品占比、强化成本管控、提高产能利用率等举措，持续改善盈利水平。后续公司将根据业务发展、项目建设及资本运作的实际需要，合理规划融资安排。公司与成都芯翼本次签署的收购意向协议仅为框架性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，具体收购比例、交易价格以及资金安排等将在公司及聘请的中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。公司资本运作围绕产业链延伸与业务协同展开，未来将根据整体发展战略，审慎推进并购、股权投资等相关事项，确保财务战略与公司长期发展战略高度匹配，为可持续发展提供坚实支撑。与此同时，公司将严格按照相关法规，及时履行信息披露义务。 **5、公司研发投入的相关情况，研发费用的具体投向；研发团队构成，核心技术人员的背景、稳定性及激励机制，产学研合作模式及外部研发合作情况，人才引进与培养机制的实施效果** 回复：公司高度重视研发创新与人才队伍建设，年度研发投入规模均达千万元以上，占营业收入比重超 4%，整体保持相对稳定趋势，研发费用主要投向功率器件封装、车规级封装、先进封装工艺、小型化与高密度封装技术及相关产品升级等核心方向，聚焦主业技术升级与产品迭代。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 177 人，占员工总数比例超 10%，研发团队以资深工程师为骨干、结构稳定；核心技术人员均拥有 20 年以上半导体行业工作经验，已经形成了一支由高级工程师带队、工程师为骨干的优秀研发团队。公司通过绩效激励、职业发展通道等多元化机制稳定核心人才。公司积极开展产学研合作，与国内高校及科研机构建立技术合作关系，推动技术成果转化；同时建立常态化人才引进与内部培养机制，不断完善研发梯队建设，为技术创新提供持续人才支撑。 **6、公司的研发战略、核心研发方向，如何应对半导体封装小型化、集成化、高功率密度的行业发展趋势，如何通过技术创新缓解行业周期波动带来的影响** 回复：公司未来将坚持技术驱动、聚焦主业的研发战略，持续加大先进封装技术投入，核心研发方向聚焦小型化、高功率密度封装、车规级功率器件、第三代半导体（SiC/GaN）封装、SIP 系统级封装、DFN/QFN 等先进封装工艺，积极顺应行业小型化、集成化、高功率密度发展趋势。公司将依托研发中心平台，按计划稳步推进研发项目实施，保障研发资金持续投入，重点实现车规级封装产业化、高功率器件封装工艺升级、先进封装量产突破等预期成果，通过技术升级持续提升产品附加值与毛利率水平。同时，公司坚持以市场需求为导向开展技术创新，优化产品结构、拓展高景气应用领域，依托差异化技术优势与数字化、智能化生产体系，提升经营稳定性，有效缓解行业周期波动带来的影响，增强核心竞争力与抗风险能力。 **7、行业发展现状、趋势、行业政策（如半导体产业支持政策）对公司发展的利好与影响** 回复：当前全球及国内半导体封装测试行业正处于周期底部爬坡、结构性复苏阶段，下游去库存逐步收尾，订单与价格边际改善，但行业分化明显，传统消费电子封装需求偏弱、产能利用率较低，而先进封装、功率器件封装需求旺盛。消费电子复苏乏力对公司传统业务带来阶段性压力，同时也推动公司加快业务结构调整，向汽车电子、工业控制、新能源等新兴领域转型。未来行业将呈现功率器件需求持续增长、先进封装技术加速升级、国产化替代纵深推进、汽车电子等新兴应用不断扩张的发展趋势。国家及地方持续出台半导体产业支持政策，在技术研发、产能建设、税收优惠及产业链协同等方面为公司提供有力支撑，有利于公司推进高端封装研发、扩大优质产能、拓展高附加值市场、提升盈利水平与综合竞争力。公司将紧抓行业复苏与产业升级机遇，聚焦功率器件、先进封装及车规级产品，优化业务结构，深化国产替代，实现稳健高质量发展。 **8、面对行业发展带来的机遇和挑战，公司未来的应对措施** 回复：公司高度重视半导体行业面临的各类风险，行业存在周期性波动、市

	场竞争加剧、原材料价格波动、技术迭代较快等风险因素。虽然公司进出口业务占比较小，国际贸易环境变化及相关政策调整对公司直接经营影响有限，但对公司下游客户端会造成较大影响，传达到公司造成间接风险。 公司已建立较为完善的风险防控体系，持续跟踪宏观环境、市场需求、供应链及政策变化，主动采取多项措施积极应对。面对行业周期波动，公司持续优化产品结构与客户结构，稳步拓展汽车电子、功率器件等高附加值领域，努力降低周期性影响；针对市场竞争加剧，公司坚持差异化发展，提升产品品质与服务能力；针对原材料价格波动，公司加强供应链管理与成本管控，稳定采购渠道；针对技术迭代加快，公司保持持续研发投入，巩固核心技术优势，不断提升风险抵御能力，保障公司经营平稳运行。 **9、公司未来发展的规划，业务拓展的方向** 回复：公司持续稳步推进募投项目产能释放，持续优化产品结构，提升功率器件、汽车电子、工业控制等高附加值产品占比，加强市场拓展与客户结构优化，加大先进封装、车规级封装等研发投入并实现产业化突破，提升产能利用率与盈利水平，进一步巩固细分领域竞争优势，完善技术与产品布局，拓展高端市场与新兴应用领域，提升综合竞争力与行业地位，推动公司高质量可持续发展。 在业务方面，公司将持续加大在工业控制、新能源汽车、物联网等新兴领域的市场拓展力度，聚焦高可靠性、高功率密度产品开发，依托已通过 IATF16949 体系认证及多款车规级功率器件 AEC- Q101 认证的优势，深化与头部客户合作，完善车规产品矩阵与质量管控体系，稳步提升车规级产品市场份额。海外市场方面，公司将以东南亚、欧洲等区域为重点目标市场，通过本地化渠道合作、客户深度开发、品牌推广等举措，依托封装成本与交付优势，稳步扩大海外客户覆盖与销售规模，提升海外市场占比。
附件清单（如有）	无
日期	2026年02月10日